



## LOTPASTE SC BLF041

Typ ISO 1.2.3.C

Die Lotpaste **SOLDER CHEMISTRY BLF 041** ist die konsequente Weiterentwicklung der sehr bewährter BLF04 Paste. Dabei wurden hier alle bisherige Erkenntnisse und Erfahrungen der nicht ganz sorgenfreien **bleifreien SMT-Anwendungen** und Kunden Wünsche berücksichtigt und einbezogen. **Besonders exzellent widerspiegelt sich das in lunkerfreien Lötstellen, für AOI-Systeme leicht und zu 100% erkennbare minimalste Rückstände. Hervorragende Benetzungskraft auch bei QFNs. LGAs etc.**

**Seit über 20 Jahren von Solder Chemistry bekannt und bewährt: eine Lagerung der SC Pasten im Kühlschrank ist absolut nicht notwendig.**

Die Anwendung von modernen chemischen Mitteln wie Kunststoffen und -harzen, Aktivatorensystemen etc. und eine sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC- und MIL-Normen lag auch ihr selbstverständlich zugrunde.

Die **BLF 041** ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem **bleifreien Lotpulver**, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf **Kunstharzbasis**, das der Kl. RE L0 nach J-STD-005 oder RMA-Qualifizierung entspricht.

Außer der hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Standzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

- \* **BLF 041\*** Exzellente Resistenz gegen Feuchtigkeit. Sehr lange Klebezeiten!!!
- \* **BLF 041\*** Bildet besonders homogene, lunkerfreie Lötstellen!
- \* **BLF 041\*** Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang! Stabile Viskosität.
- \* **BLF 041\*** Eine feststoffarme Paste mit nur 4,3% Rückstand bei 88 Metallgehalt.
- \* **BLF 041\*** Die Rückstände entsprechen der RE L0 Klassifizierung.
- \* **BLF 041\*** Hinterlässt keine teerartigen Rückstände in der Lötanlage.
- \* **BLF 041\*** Lötet problemlos auch auf leicht korrodierten Oberflächen.
- \* **BLF 041\*** Rückstände sind mit allen wasserbasierenden Reiniger entfernbar!

### PHYSIKALISCHE DATEN

<u>Bevorzugte Legierungen</u>	<u>Schmelzpunkt</u>	Gemäß Internationalem Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen:
Sn96,5/Ag3,5	221°C	Kl.3 (T3) 25 - 45 µm Kl.4 (T4) 20 - 35 µm Kl.5 (T5) 10 - 25 µm
Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7	217 - 219°C	
<b>Sn96,5/Ag3/Cu0,5</b>	217°C	
Sn99,3/Cu0,7	227°C	
Sn97/Cu3	227 - 300°C	
<b>Sn90/Ag3,5/In6/Bi0,5</b>	<b>202-210°C</b>	

**VISKOSITÄT** (Pa.S) ± 10% gemessen nach Brookfield RVT-DV II Viskosimeter mit 89% Metallgehalt:

<u>Viskosität:*</u>		Konturenstabilität – DIN 32513		Solderballing nach IPC	Benetzung nach IPC
		Sofort	20min 80°C		
650 Pas	Pulverklasse III	Kl.1 = 0,2	0,2	1	1
700 Pas	Pulverklasse IV	Kl.2 = 0,2	0,3		

## OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Messung am	4.Tag	<u>21.Tag</u>
	$2,4 \times 10^{11}$	$2,8 \times 10^{11}$

### QUALIFIKATIONEN

Die Lotpaste **BLF 041** ist eine RMA-Paste die den Anforderungen der MIL-QQ-S571e entspricht. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung (nach DIN 32513) wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der RE L0 entsprechende, Rückstände, die auf der Leiterplatte verbleiben können.

### VERBRAUCHERHINWEISE

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst dicht verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozess darf selbstverständlich neue Paste der älteren zur Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen sollte man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15 – 100 mm/s.

Merke! Der Pastendruker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in der Linie.  
Das Wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 88% Metallgehalt empfohlen.

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen.

**Wir empfehlen daher den SC Schablonenreiniger.** Die Lotpaste ist mit allen gängigen Reflow-Systemen aufschmelzbar.

### LAGERUNG

Ungeöffnetes Gebinde – Dosen(!) bei ca. 20°C (RT): 6 Monate

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird. **Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht mehr notwendig!**

So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste:

<u>Legende</u>	<u>Pastentyp</u>	<u>Korngröße</u>	<u>Legierung</u>	<u>Flußmittelanteil</u>	<u>Gebindegröße</u>
z.B.	BLF 041	T3	96,5/Ag3/Cu0,5	12%	500g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste (SC...)                      L-Sn96,5Ag3Cu0,5 / 1.2.3.C / 88 - 3                      500g (Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut

Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020

e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.